

【応募要領】技術交流会へのエントリーについて

以下は、技術交流会にご参加頂くためのエントリーについてのご案内となりますので、内容をご確認下さい。積極的なご提案をお待ちしております。

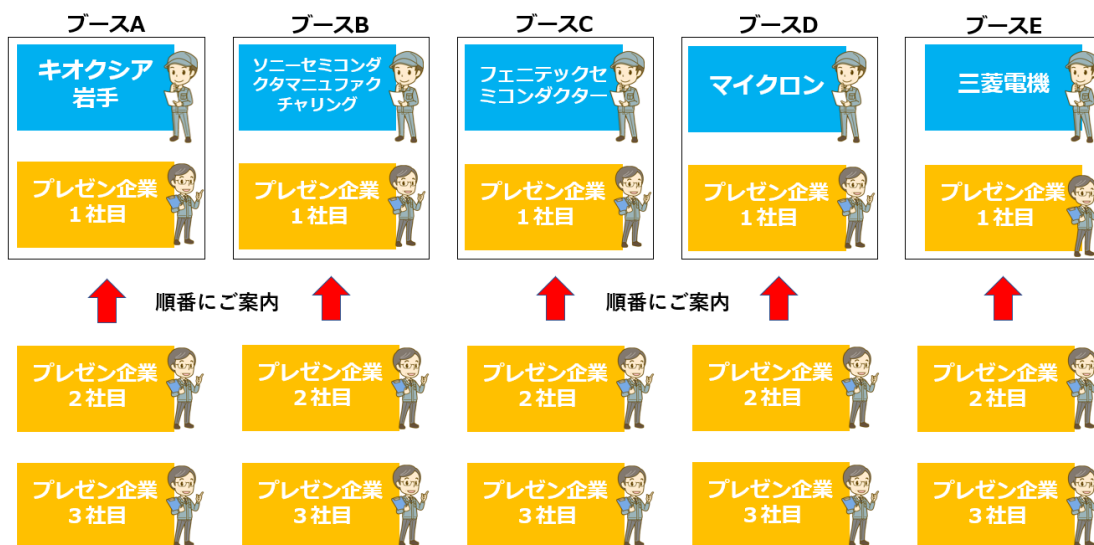
なお、ここでご提案頂いた内容は、今回の技術交流会とその後のマッチング以外の目的で利用することはありませんので、可能な範囲で詳細にご記入下さい。また、皆様の連絡先は、関連事業（セミナーやワークショップのご案内など）に使用させて頂く場合がございますが、それ以外でご本人の同意なく第三者に開示・提供することはありません。

1. 概要

技術交流会では、以下5社の半導体メーカーに対して、技術を提案する「プレゼン企業」を募集し、その後の個別商談に展開する「きっかけの場」を提供します。

<半導体メーカー>

- ・キオクシア岩手株式会社
- ・ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
- ・フェニテックセミコンダクター株式会社
- ・マイクロンメモリ ジャパン株式会社
- ・三菱電機株式会社パワーデバイス製作所



※プレゼン企業数は、半導体メーカーごとにプレゼンを受けたい企業を選択するため、ブースごとに異なります。（詳細は後述）

2. 技術交流会へのエントリー可能企業（プレゼン企業）について

①以下の会員企業

- ・東北半導体・エレクトロニクスデザイン研究会
- ・いわて半導体関連産業集積促進協議会（I-SEP）
- ・中国地域半導体関連産業振興協議会
- ・九州半導体人材育成等コンソーシアム
- ・九州半導体・デジタルイノベーション協議会（SHIQ）

②（全国の）地域未来牽引企業

本技術交流会において、プレゼン企業は、上記の東北地方、中国地方、九州地方の半導体協議会等をはじめ、全国の「地域未来牽引企業」から募集します。

現時点で、こうした協議会等に参加されていない企業は、並行して入会の手続きをお願いいたします。

※ご自身の企業、機関がある地域において、こうした協議会（コンソーシアム）が設立されていない場合は、中国地域半導体関連産業振興協議会に入会してください。全国の企業を対象に会員を募集しています。

※地域未来牽引企業の場合は、上記協議会等への入会は必須要件ではありません。

（参考）

■東北半導体・エレクトロニクスデザイン研究会

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_monozukuri/mono_hando.html

【お問い合わせ先】

東北経済産業局 地域経済部 製造産業・情報政策課

電話：022-221-4903

E-mail：bzl-thk-handotai@meti.go.jp

■いわて半導体関連産業集積促進協議会（I-SEP）

<https://www5.pref.iwate.jp/~hp0405/i-sep/index.html>

【お問い合わせ先】

岩手県商工労働観光部 ものづくり自動車産業振興室

電話：019-629-5560

E-mail：AB0005@pref.iwate.jp

■中国地域半導体関連産業振興協議会

<https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/handoutaikanrensangyou.html>

【お問い合わせ先】

中国経済産業局 地域経済部 製造・情報産業課（半導体関連産業担当）

電話：082-224-5760

E-mail：bzl-monozukuri02@meti.go.jp

■九州半導体人材育成等コンソーシアム

https://www.kyushu.meti.go.jp/press/2203/220329_1.html

【お問い合わせ先】

九州経済産業局 地域経済部 情報政策課

電話：092-482-5440

E-mail：bzl-jyosei-kyu@meti.go.jp

■九州半導体・デジタルイノベーション協議会（SIIQ）

<https://www.siiq.jp/>

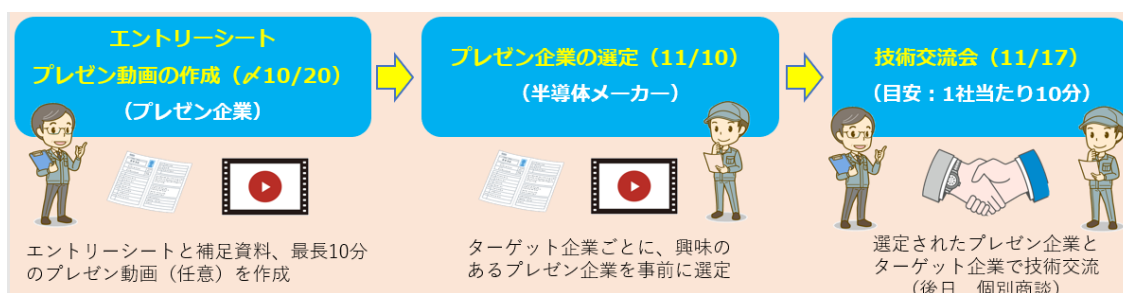
【お問い合わせ先】

九州半導体・デジタルイノベーション協議会（SIIQ）

電話：092-473-6649

E-mail：info@siiq.jp

3. 全体の流れ



(1) 半導体メーカーの技術ニーズ

各企業が求める技術については、別紙「半導体メーカーの技術ニーズ」をご覧ください。

(2) エントリー

<ご提出いただくもの>

- ・【必須】 エントリーシート（ファイル形式は、Word）
- ・【任意】 補足説明資料（パンフレット、チラシ等の電子媒体（PDF等））
説明動画（ファイル形式は「.MP4」、「.MOV」。最長10分）も可。

技術交流会当日は、プレゼン時間が一社当たり10分程度となるため、当日の時間が短くプレゼンしきれない可能性がある場合や、動いているものを見せたい場合等には、補足説明資料として事前に半導体メーカーに見ていただくための説明動画を作成いただいても結構です。

※いずれも、機密情報を含まない公開可能情報のみの内容で作成してください。

プレゼン企業としてご参加頂くには、別紙エントリーシートの作成をお願いします。
提案内容への理解を深めるため、補足説明資料（チラシ、パンフレット等）がある場合は添付して下さい（補足説明資料の書式は任意であるが、電子媒体に限る。）。

ご提出頂いたエントリーシートと説明動画は、基本的には上記5社すべて（あえて提案を避けたいプレゼン企業がある場合を除く。詳細は、別紙「エントリーシート6.」を参照。）に提供します。

エントリーシート、説明動画ともに、上記5社が提案技術を選考する際の材料となりますので、可能な範囲で具体的な記入・作成をお願いします。

[1] エントリーシートと補足説明資料（説明動画を含む。）の提出期間

2023年10月3日（火）～10月20日（金）12:00（必着）

[2] 提出方法

エントリーシート、説明動画及び補足資料は、以下のアドレスまでご送付ください。
必要に応じ、「大容量ファイル共有サービス」等をご活用願います。

gijutsu-koryukai@ymfg.ym-zop.co.jp

* 送付頂いた資料は、半導体メーカー5社の他、必要に応じ、東北、中国、九州地方等の経済産業局が事務局をつとめる半導体産業振興に係る協議会（研究会、コンソーシアム等）に提出することがあります。予めご了承ください。

(3) 半導体メーカーによる選考

半導体メーカー5社に、エントリーシート及び任意作成の補足説明資料（説明動画を含む。）をご確認いただき、技術交流会の場で、対面での説明を希望するプレゼン企業をご選考頂きます。

選考の結果、技術交流会への参加に至らない場合もあります。選考結果については、ご提案いただいたすべての企業にご連絡します。また、選考結果に関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。

<選考期間>

提案があったものから随時～11月9日（木）

※事務局は、提案があったエントリーシート等を随時、半導体メーカー5社に共有いたします。

<プレゼン企業への選考結果通知>

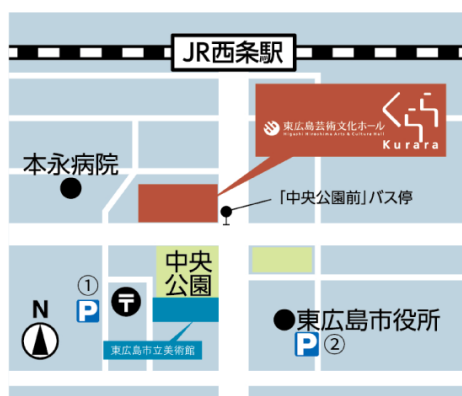
2023年11月10日（金）

(4) 技術交流会

上記の選考を通過した企業に、事務局から詳細な案内を連絡します。

なお、技術交流会は、以下のとおり開催します。

日 時 2023年11月17日(金) 14:30～17:30
会 場 東広島芸術文化ホール くらら (広島県東広島市西条栄町7-19)
<https://kurara-hall.jp/access/>



※駐車場

市営西条岡町駐車場(東広島市西条岡町1111番地9) 収容台数:228

[営業時間]0時～24時(終日)

2時間まで駐車料金が無料になります。

駐車券を「くらら総合案内・事務室」にお持ち下さい。

※会場までの交通費は自己負担となります

プレゼン方法 一社あたり10分程度(質疑応答時間を含む)

※会場参加できない方はオンラインでの参加が可能です。

※半導体メーカー及びプレゼン企業のオンライン参加者をWebex Meetingsでつなぎます。(詳細は、選考が決まってからお伝えします)

※ピッチ時間及び質疑応答時間は、半導体メーカーごとに選定した企業数に応じて調整します。

参加費 無料

(5) 名刺交換会・懇親会

会場にお越し頂ける方には、技術交流会の後に名刺交換会・懇親会を開催します。

日 時 2023年11月17日(金) 18:00～20:00

場 所 ソラオト(東広島芸術文化ホールくらら内)

会 費 4,500円(飲食込み)

出欠確認 (追って、プレゼン企業にはお伝えいたします。)

(6) その他

半導体メーカー5社以外にも、全国の経済産業局が事務局をつとめる半導体関連産業振興に係る協議会（コンソーシアム等）で、事業者間マッチング支援を展開しておりますので、事務局から後日連絡させて頂くことがあります。

また、本技術交流会のフォローアップのために、商談状況を確認することもございますので、ご理解願います。

3. 技術交流会に関するお問い合わせ先

【技術交流会事務局】株式会社 YMFG ZONE プラニング

TEL : 083-223-4202 (受付時間 9時~17時)

Email : gijutsu-koryukai@ymfg.ym-zop.co.jp

* 本事業は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「特定半導体の安定供給体制の構築・維持に必要な人材の育成及び確保並びにサプライチェーンの強靱化に関する調査事業」の一環で実施いたします。